



第 28 回電子デバイス実装研究委員会 公開シンポジウム

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。下記のとおり、第 28 回電子デバイス実装研究委員会を公開シンポジウムとして開催いたします。

電子デバイス実装研究委員会では、ますます小型化・複雑化する電子・精密機器の製造において不可欠なソルダリング、マイクロ/ナノ接合、表面処理、切削加工、放熱設計、微小領域の信頼性評価・分析方法など先進的なテクノロジーについての学術的な議論をおこなっております。今回は近年注目が高まっている高温耐熱実装に関する技術を中心に、バイオミメティクス・バイオセンシング関連の実装技術に関するトピックスも集めております。公開シンポジウムにすることで、より広範の研究者・技術者の方と情報交換することができ、本分野のさらなる発展が期待できます。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

主催（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
共催：（一社）エレクトロニクス実装学会（依頼中）

- 開催日時：** 令和 元 年 11 月 27 日（水） 10:30～16:20
開催場所： 日本橋ライフサイエンスビルディング 201 大会議室
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 11 号
定 員： 先着 100 名 [申込み締切り：令和元年 11 月 18 日（月）]
参加費： 10,000 円（非会員、資料代含む）
申込方法： 以下のエレクトロニクス生産科学部会ホームページの申込みフォームよりお申込み下さい。
<http://sps-mste.jp/committee/>
※お支払いは、受付完了メールに記載された振込先まで銀行振り込みにてお願いいたします。

プログラム

10:30～ 12:00	『難しいフラックス洗浄に挑む MPC 洗浄の有用性』 (45 分)	○加納 裕也（ゼストロンジャパン(株)）
	『パワーデバイス向け接合材料の 最新動向』 (45 分)	○北沢 和哉（千住金属工業(株)）
12:00～13:00	休 憩	
13:10～ 14:40	『WBG デバイスと周辺主要部品の モジュール化技術の研究』 (45 分)	○高橋 良和、遠藤 哲郎（東北大学）
	『Ni を接続材料とする新たな 高温耐熱実装技術』 (45 分)	○巽 宏平（早稲田大学）
14:40～14:50	休 憩	
14:50～ 16:20	『表面張力を利用したバイオミメティク ス液体操作－撥水・吸着・輸送－』(45 分)	○石井 大佑（名古屋工業大学）
	『ヘルスケア・医療応用のための 生体計測用バイオセンシング技術』 (45 分)	○荒川 貴博、三林 浩二（東京医科歯科 大学）